Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 118 (2000)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



5. Spenglertag, 23. März 2000

Abdichten und Dämmen im Hochbau

traditionell, fortschrittlich, grün

Zur Tagung / Ziel der Tagung

Das Flachdach erlebt eine neue Konjunktur. Besonders begrünte Flachdächer prägen immer mehr unsere Baulandschaft. Neue und verbesserte Materialien und Erkenntnisse bringen auch neue Techniken und Änderungen in bauphysikalischer und ausführungstechnischer Hinsicht mit sich. Darum wird die neue SIA 180 vorgestellt. Den Tagungsteilnehmern werden neue Techniken und Lösungen vorgestellt, welche für Bauherren, Architekten sowie Unternehmer technisch und wirtschaftlich interessant sind. Im Weiteren wird auch die Auswirkung der im September zur Abstimmung kommenden Energieabgabe auf den Beschäftigungseffekt im inländischen Baugewerbe für das Flachdach dargestellt.

Datum	Mittwoch, 23. März 2000, 8:30 - ca. 17:00 Uhr	09:00	P. Holinger	Begrüssung
		09:15	J. Schoop	Einführungsreferat
Tagungsort	Sport- und Erholungszentrum			
	Tägerhard, 5430 Wettingen	09:30	A. Eggenberger	Praktische Auswirkung der neuen Norm SIA 180
Tagungsbeitrag	Fr. 150 Mitglieder SSIV	10:15	H. Fahrni	Dämmstoffe im bituminösen
	Fr. 200 Sonstige Teilnehmer			Flachdach
	Inkl.:	11:00		Ausstellung, Apéro, Mittagessen
	Kaffee und Gipfeli, Apéro, Mittag-		a	
	essen,	13:45	P. Imfeld	Neue bituminöse Abdichtungstech-
	Tagungsbroschüre und			niken - effizienter und wirtschaftli-
	Besuch der Fachausstellung	14:30	JM. Groh	cher verlegt 3S-Dach
Teilnehmer	Architekten, Bauherren, Planer,	14.50	JIVI. GIOII	Ein System mit Zukunft
	Unternehmer, Berater, leitende	14:45	F. Hämmerle	Dachbegrünung - Chance oder
	Angestellte, Handel und Industrie		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Risiko
		15:30		Pause
Ausstellung	Auf über 850 m² präsentieren			
	die wichtigsten Hersteller und	16:00	J. Schoop	Zusammenfassung der Referate
	Lieferanten ihre Produkte und			
	Systeme.	16:15	B. Scherrer	Schlussdiskussion
0				
				

Anmeldung

Bitte per Brief oder Fax bis **Mittwoch**, **23**. **Februar 2000**, an: Schweizerischer Spenglermeister- und Installateur-Verband (SSIV),

Heide Ungricht-Arendt, Postfach 63 40, 8023 Zürich, Fax 01 / 269 74 98

Ich/Wir melde(n) mich/uns verbindlich für den Spenglertag vom 23. März 2000 an. Ich/Wir habe/n davon Kenntnis genommen, dass bei einer Tagungsabmeldung nach dem 08.03.2000 eine Umtriebsgebühr von Fr. 80.-- pro Person zu entrichten ist.

Firma	PLZ/Ort
Strasse	Telefon
Teilnehmer	Teilnehmer
Ort/Datum	Unterschrift